

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

公告编号：2025-054

芯联集成电路制造股份有限公司

关于公司向控股子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● **增资标的名称：**芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司（以下简称“芯联先锋”）

● **增资金额：**人民币 18 亿元

● **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

本次交易无需股东大会审议

本次增资事项尚需芯联先锋股东会审议通过后方可实施

一、本次增资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

基于公司的整体战略发展规划和实际经营需求，看好功率模组应用配套所需各类芯片的市场发展，以及新型政策性金融工具的落实和推进的重要契机，公司拟向控股子公司芯联先锋增资人民币 18 亿元，保障“三期 12 英寸集成电路数模混合芯片制造项目”的持续实施。增资后，芯联先锋的注册资本不低于 1,329,244.16 万元，其他股东拟放弃优先认购权，芯联集成对芯联先锋的持股比例不低于 50.85%。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐ 新设公司 ☒ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☒ 非同比例） --增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）： <u>180,000</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☐ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☒ 其他： <u>新型政策性金融工具</u> ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

公司于2025年10月16日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向控股子公司增资的议案》，本事项无需提交股东大会审议。

（三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、标的基本情况

（一）标的概况

2023年公司通过审议决定由公司控股子公司芯联先锋实施三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目，预计总投资222亿元人民币，形成10万片/月的产

能规模，产品可广泛应用于新能源、汽车、工控、消费等领域。目前产线已完成前期建设，相关各个工艺平台均已进入规模量产阶段。

(二) 标的的具体信息

(1) 增资标的基本情况

投资类型	☒ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☒ 非同比例）
标的公司类型（增资前）	控股子公司
法人/组织全称	芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司
统一社会信用代码	☒ <u>91330602MA7G7TEL24</u> ☐ 不适用
法定代表人	赵奇
成立日期	2021/12/24
注册资本	1,167,082 万人民币
实缴资本	1,167,082 万人民币
注册地址	浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号-17
主要办公地址	浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号-17
控股股东/实际控制人	芯联集成电路制造股份有限公司
主营业务	一般项目：集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电子元器件制造；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；（限自有房屋租赁）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
所属行业	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业

(2) 增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1,365,573.02	1,430,501.66
负债总额	506,683.81	547,382.34
所有者权益总额	858,889.21	883,119.32

资产负债率	37.10%	38.27%
科目	2025 年 1-6 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	57,392.56	83,868.21
净利润	-58,352.18	-129,944.51

（三）出资方式及相关情况

公司本次增资的方式为现金出资，资金来源为新型政策性金融工具资金。

三、交易标的评估、定价情况

本次增资价格不超过 1.11 元/注册资本，交易定价系综合考虑芯联先锋的发展状况、发展潜力、未来发展规划等因素，并以后续评估报告的评估值为基础，需经各方协商确定。本次公司拟向芯联先锋增资 18 亿元，增资后芯联集成对芯联先锋的持股比例不低于 50.85%。由于评估尚在进行中，本次增资扩股数量目前尚未确定，因此公司持有的芯联先锋股份占芯联先锋增资扩股后总股本的比例最终以芯联先锋工商注册总股本为准。

四、拟签署增资相关协议的主要内容

（一）签署主体

1. 芯联集成电路制造股份有限公司
2. 绍兴滨海新区芯瑞创业投资基金合伙企业（有限合伙）
3. 绍兴富浙越芯集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
4. 工融金投一号（绍兴）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
5. 中鑫芯联股权投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙）
6. 绍兴交汇先锋集成电路股权投资基金合伙企业（有限合伙）
7. 建源芯联（绍兴）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
8. 浙江富浙绍芯集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）

9. 芜湖信石信芯股权投资合伙企业（有限合伙）
10. 华芯锋私募股权投资基金(青岛)合伙企业(有限合伙)
11. 芜湖信石华芯股权投资合伙企业（有限合伙）
12. 芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司

上述任何一方单称为“一方”，合称为“各方”；芯联集成为“本轮投资方”。

（二）增资总体安排

各方同意按照本协议的约定，芯联集成增资人民币 180,000.00 万元

（三）投资款的缴付

在交割先决条件均得到满足或被本轮投资方豁免的前提下，芯联集成在 2025 年 12 月 31 日前完成出资。

本轮投资方按约定实际将全部的投资款按期划入芯联先锋指定的银行账户之日为交割日，就本轮增资新增注册资本而言，芯联集成自交割日起享有新增部分股权的股东权利并承担新增部分股权的股东义务。

芯联先锋应于交割日后的五（5）个工作日内，向本轮投资方递交截至交割日符合公司法要求的股东名册（经法定代表人签字并加盖公司印章）。

（四）违约责任

1、一方若未能按照本协议的约定按期、足额缴纳出资的，每延期一日，应按照应缴未缴金额的万分之五的标准向芯联先锋支付滞纳金。

2、除本协议其他条款另有约定外，由于本协议任何一方违反本协议规定的义务，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约行为而给守约方造成的全部实际损失。如存在两方以上有违约行为，则由违约各方按照其各自的违约程度分别承担违约责任。

3、本协议项下各方均分别承担违约责任，不存在任何性质的连带违约责任。

4、各本轮投资方在本协议项下的权利和义务为分别且不连带的，任何本轮

投资方均不对其他本轮投资方的行为承担任何责任，且任何本轮投资方对其权利的行使或豁免均不影响其他本轮投资方行使或豁免其任何权利。

（五）法律适用和争议解决

1、本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决应受中国法律的管辖，并依其解释。

2、凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决。如果争议在首次协商后六十（60）日内不能以各方可接受的方式解决，则任何一方有权将该等争议、纠纷或索赔提交本协议签署地有管辖权的人民法院通过诉讼的方式解决。

3、争议解决期间，各方继续拥有各自在本协议项下的其它权利并应继续履行其在本协议下的相应义务。

（六）协议的生效、补充、修改、变更和解除

1、本协议经协议各方法定代表人/执行事务合伙人委派代表或其授权代表签字（章）并加盖公章后成立并生效。特别地，本协议一经协议各方法定代表人/执行事务合伙人委派代表或其授权代表签字（章）并加盖公章，即视为该方已完成所有其所必须的内外外部批准/授权程序，各方同意并确认在本协议项下不存在任何在协议生效后仍须履行的内外外部批准/授权程序。

2、经本协议各方协商一致，可以对本协议进行修改或变更。任何修改或变更必须制成书面文件，经本协议各方法定代表人/执行事务合伙人委派代表或其授权代表签字（章）并加盖公章后成立并生效。

五、对上市公司的影响

公司本次增资的资金来源为新型政策性金融工具，政策性金融工具资金期限长、利率低，能有效降低公司的整体资金成本，减轻公司融资负担，符合国家金

融重点支持政策。

本次增资巩固了上市公司对子公司的控制权，有利于公司的长远发展，符合公司整体战略规划，有助于公司扩大市场规模，提升市场竞争力。

本次增资预计不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、风险提示

（一）本次增资事项尚需芯联先锋股东会审议通过后方可实施。

（二）本项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，可能导致该项目的经营状况及盈利能力不达预期。

（三）如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更的风险。

（四）公司将根据项目进展情况，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日